

TM 230D 可焊接導電膠 产品数据表

提高可靠性
改善導熱性
消除氣體逸出

简介

TM 230D 可焊導電膠是一種快速固化、自填充、自流平且可自焊接的膠粘劑，可用作 LED、CSP, QFP 等器件的芯片粘接膠，以替代導電膠(銀膠)或焊料(例如焊膏或預成型焊料)。與導電膠(銀膠)相比，TM 230D 可焊導電膠具有更高的穩定電導率和導熱率，能夠輕鬆填充間隙並使晶片自流平，且易於控制黏接厚度。與傳統焊料相比，TM 230D 可焊導電膠消除了焊接過程中的氣體逸出、晶片傾斜和位移以及焊料溢出等問題。TM 230D 可焊導電膠固化後，焊接界面將被封裝，從而使焊接金屬界面受到三維聚合物網絡的保護，能夠耐受惡劣的環境條件。

物理特性

产品名称	TM 230D 可焊黏合劑
樹脂類型	環氧樹脂
合金	銀
未固化材料性能	
项目	数值
比重(ASTM D1475-60)	3.5 – 4.5 g/cc
黏度(@35°C)	200 – 250 kcp
已固化材料性能	
拉伸強度(MPa)	53
C.T.E (ASTM E831) PPM/°C	21.7
楊氏模量 (GPa)	41.6
導熱係數 (w/m.k)	110

表面絕緣電阻	經過
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
熱性能	
熱衝擊測試 (-65/+125 °C)	100個循環, 3級
抗紫外線黃變性能, 小時	>500

推荐干燥/固化工艺

典型的無鉛回流焊接曲線可以評估其他固化曲線。

储存与保质期

在 -40 °C 以下条件下, 如材料保持于密封的原始容器中, 保质期为 6 个月。

超过该存储期限, 材料粘度可能会升高。请避免材料受到水分、挥发损失及异物污染, 否则可能对产品的加工性能产生不利影响。

安全信息

TM230D 为环保型、无毒材料。但在操作和使用过程中, 仍建议遵循基本的工业卫生规范。有关更详细的安全信息, 请参阅本产品的 材料安全数据表。

包装规格

TM 230D 可焊膠有 10cc 和 30cc 兩種規格。其他包裝規格可依客戶要求客製化。請聯絡 YINCAE 以取得訂購資訊。